

欣旺达电子股份有限公司

关于对外投资建设欣旺达SiP系统封测项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、交易基本情况

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2023年3月7日召开第五届董事会第四十八次会议、第五届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于对外投资建设欣旺达SiP系统封测项目的议案》，同意欣旺达全资子公司浙江欣旺达电子有限公司（以下简称“浙江欣旺达”）在浙江省兰溪市投资建设“欣旺达SiP系统封测项目”（以下简称“SiP项目”或“项目”）。

截至本公告日，浙江欣旺达与浙江省兰溪市人民政府（以下简称“兰溪市政府”）已签署《欣旺达SiP系统封测项目投资协议书》（以下简称“《项目投资协议书》”）。浙江欣旺达计划对该项目总投资26亿元（其中项目建设及相关投入约为22亿元，约4亿元用于项目建设完成后日常营运资金），用于从事SiP系统封测技术研发、电池模组电源管理系统封装、消费类电子SiP系统封装模组和电池模组的生产与销售。浙江欣旺达已于兰溪市成立全资项目公司浙江欣威电子科技有限公司（以下简称“浙江欣威”或“项目公司”），负责该项目的建设实施、开发、运营。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《欣旺达电子股份有限公司章程》、《欣旺达电子股份有限公司对外投资管理制度》等相关制度，上述交易事项不构成关联交易。本次交易事项属于董事会职权范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

机构名称：兰溪市人民政府

统一社会信用代码：113307817410001478

机构类型：机关

注册地址：兰溪市府前路81号

法定代表人：朱俊华

履约能力分析：兰溪市政府为地方机关单位，具有充分履约能力。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，兰溪市政府不是失信被执行人。

与公司关联关系说明：根据《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，兰溪市政府不属于公司关联方，与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

三、《项目投资协议书》的主要内容

甲方：兰溪市人民政府（以下简称“甲方”）

乙方：浙江欣旺达电子有限公司（以下简称“乙方”）

甲方是兰溪市人民政府，将欣旺达SiP系统封测项目作为当地重点项目，为乙方欣旺达SiP系统封测项目落户提供相关政策支持。

乙方为欣旺达控股子公司，拟在甲方兰溪市从事SiP系统封测技术研发、电池模组电源管理系统封装、消费类电子SiP系统封装模组和电池模组的生产与销售，并负责组织项目的投资建设运营。

1、项目内容

项目名称：欣旺达SiP系统封测项目

主要产品：电池模组管理系统，平板及笔记本电脑电池模组，消费类电子SiP系统封装模组

2、项目投资计划

本项目总投资：人民币26亿元（大写金额：人民币贰拾陆亿元整），其中项目建设及相关投入约为22亿元，约4亿元用于项目建设完成后日常营运资金。

3、项目建设计划

乙方拟使用兰溪市雁州路111号欣旺达浙江锂威产业园5#、6#厂房，投资新建包括生产车间、仓储、办公、电力等配套设施。

4、违约责任与免责

甲乙双方均应信守承诺，严格履约。任何一方违约的，守约方有权中止履行其相应义务，书面要求违约方依照本协议约定继续履行。违约方在收到履约通知书后30日内仍未能履行的，守约方有权解除协议，并有权要求违约方承担因此给守约方造成的一切损失。

5、适用法律及争议解决

5.1 本协议订立、效力、解释、履行及争议均适用中华人民共和国法律。

5.2 本协议在执行过程中若遇国家相关政策法规的调整，使得本协议条款中内容与政策法规有抵触或不符合的，按新的政策法规执行。

5.3 本协议履行过程中如发生争议，由双方友好协商解决；协商不成的，按本条第（2）项约定的方式解决：

（1）提交浙江仲裁委员会仲裁；

（2）依法向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

6、协议生效条件

本协议经双方签字盖章之日起成立，并在以下条件满足时生效：协议各方确认已履行相应的法定审议程序审议通过本协议事项。

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次公司全资子公司浙江欣威拟于兰溪市政府辖区内投资建设“欣旺达SiP系统封测项目”系为了推进公司SiP业务的发展，拓宽与下游客户的合作深度及广度，实现公司的战略规划，进一步提升公司的持续经营能力以及综合竞争力。公司将以该项目作为募投项目，向特定对象发行股票募集资金用于项目建设。本次交易不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、本次对外投资存在的风险

1、本次项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。

2、本次项目规划的投资金额较大，且资金来源大部分需向特定对象发行股票募集，最终能否成功发行具有不确定性，因此产生因资金原因导致合作项目无法按期投入、完成的风险。

公司将密切关注本次项目的后续进展情况，及时控制风险，保障公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、履行的必要程序

1、公司第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于对外投资建设欣旺达 SiP 系统封测项目的议案》，董事会同意公司全资子公司浙江欣威于兰溪市政府辖区内投资建设“欣旺达 SiP 系统封测项目”的事项。

2、公司第五届监事会第四十八次会议审议通过了《关于对外投资建设欣旺达 SiP 系统封测项目的议案》，监事会认为：本次公司全资子公司浙江欣威投资建设“欣旺达 SiP 系统封测项目”系出于自身发展的需要并经过充分评估和论证。本次项目的投资建设系为了推进公司 SiP 业务的发展，拓宽与下游客户的合作深度及广度，实现公司的战略规划，进一步提升公司的持续经营能力以及综合竞争力。因此，监事会同意公司全资子公司浙江欣威在兰溪市政府辖区内投资建设“欣旺达 SiP 系统封测项目”的事项。

3、公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事同意公司全资子公司浙江欣威在兰溪市政府辖区内投资建设“欣旺达 SiP 系统封测项目”的事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第四十八次会议决议。
- 2、第五届监事会第四十八次会议决议。
- 3、独立董事对第五届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见。
- 4、《欣旺达SiP系统封测项目投资协议书》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2023年3月8日